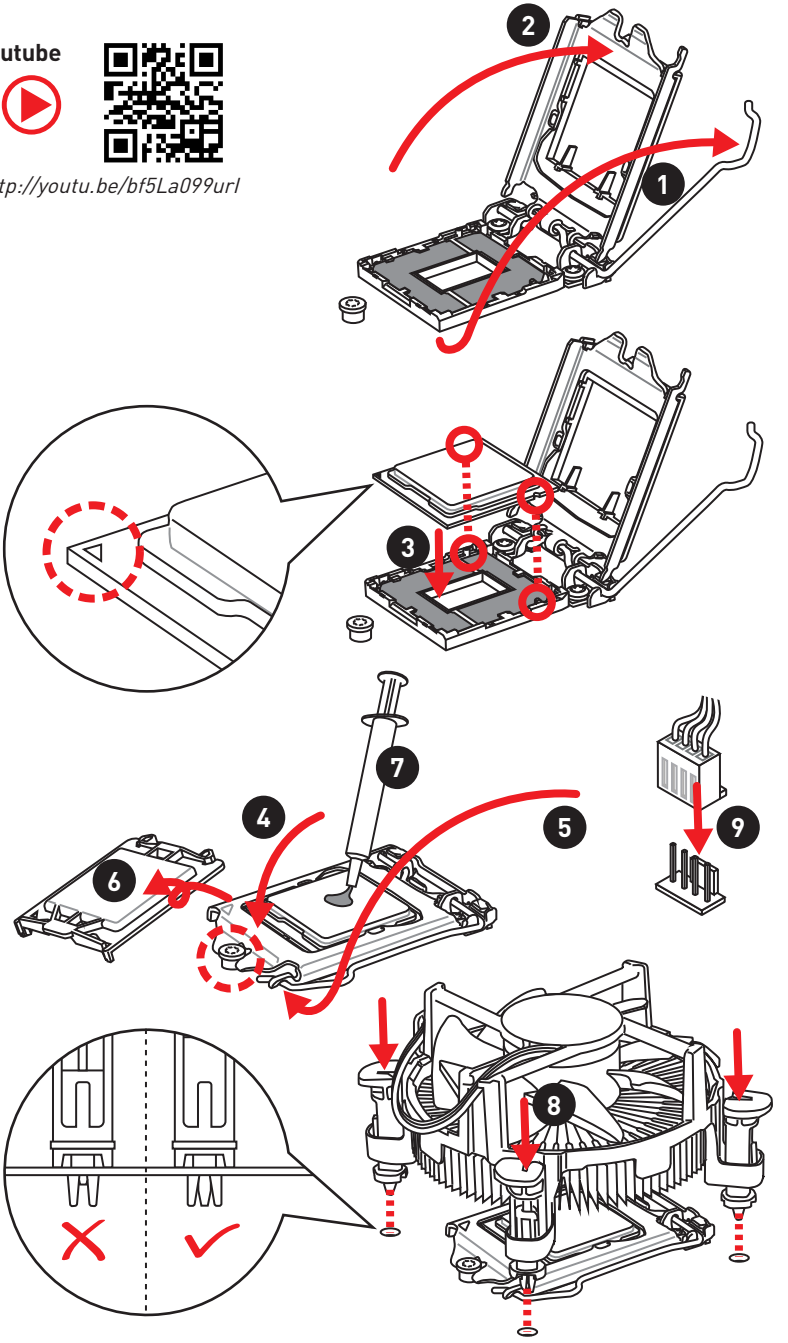
퀵 스타트

MSI® **B360M BAZOOKA PLUS** 메인보드를 선택해주셔서 감사합니다. 이 부분에서는 컴퓨터를 설치하는 방법에 대한 데모 다이어그램과 일부 데모 동영상을 제공하고 있습니다. 휴대전화 또는 태블릿의 웹 브라우저를 통하여 URL에 링크한 후 설치 동영상을 감상하시기 바랍니다. 또는 QR 코드를 스캔하여 URL에 링크할 수도 있습니다.

프로세서 설치하기

Youtube

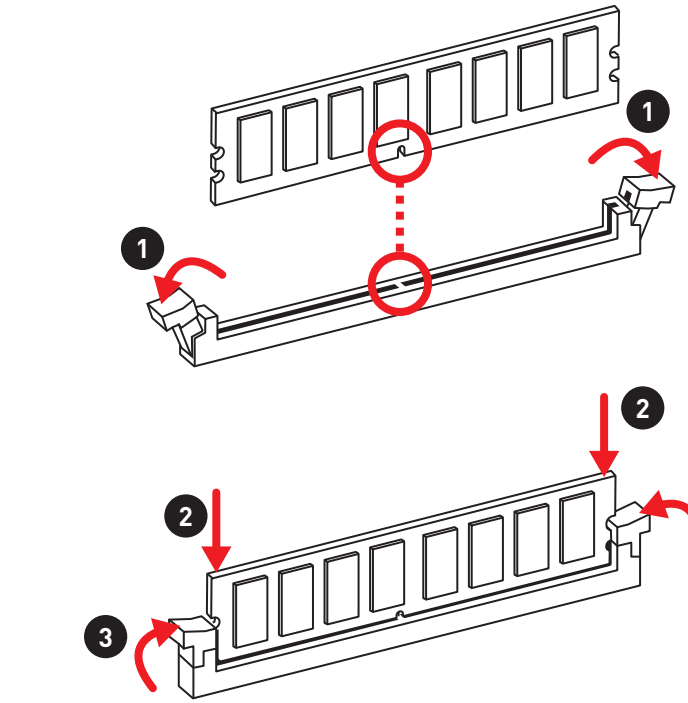
http://youtu.be/bf5La099url

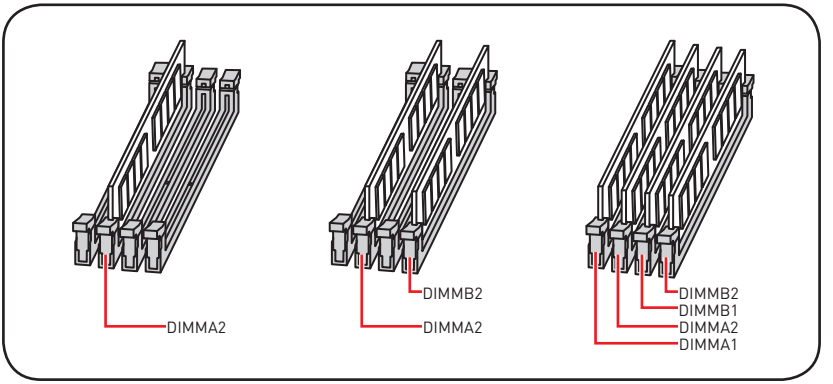


DDR4 메모리 설치하기

Youtube

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

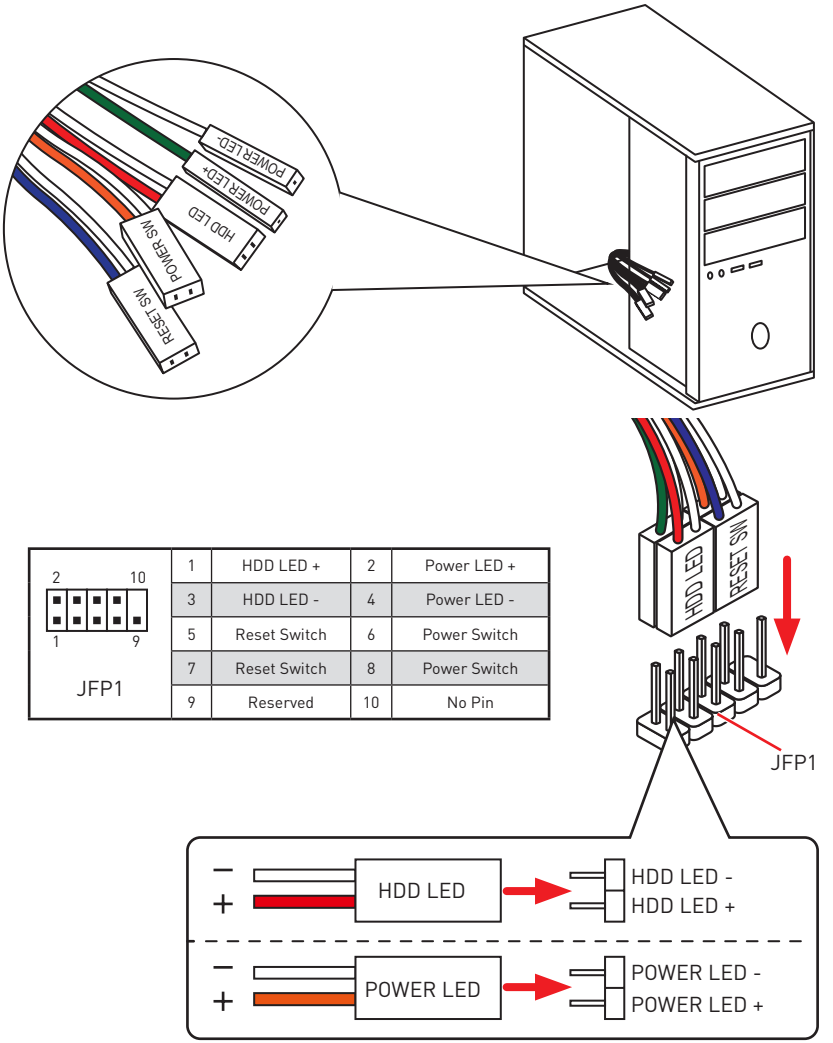




전면 패널 커넥터 연결하기

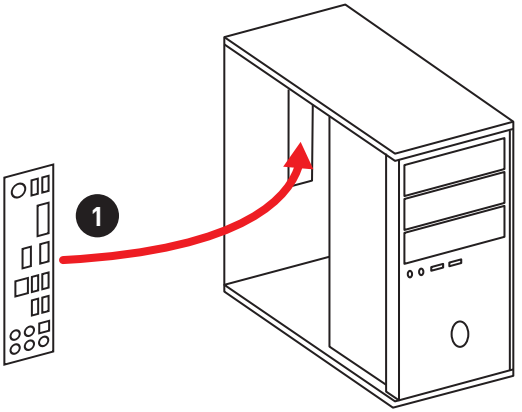
Youtube

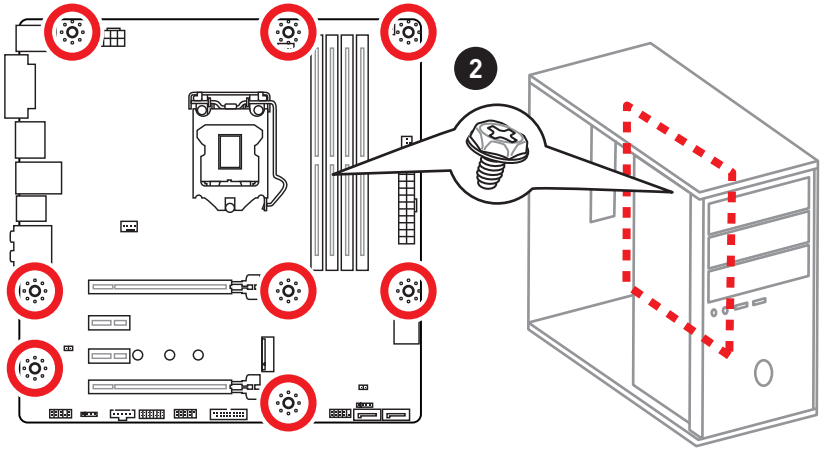
http://youtu.be/DPELIdVNZUI



2 10 / 1 9 JFP1	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

메인보드 설치하기

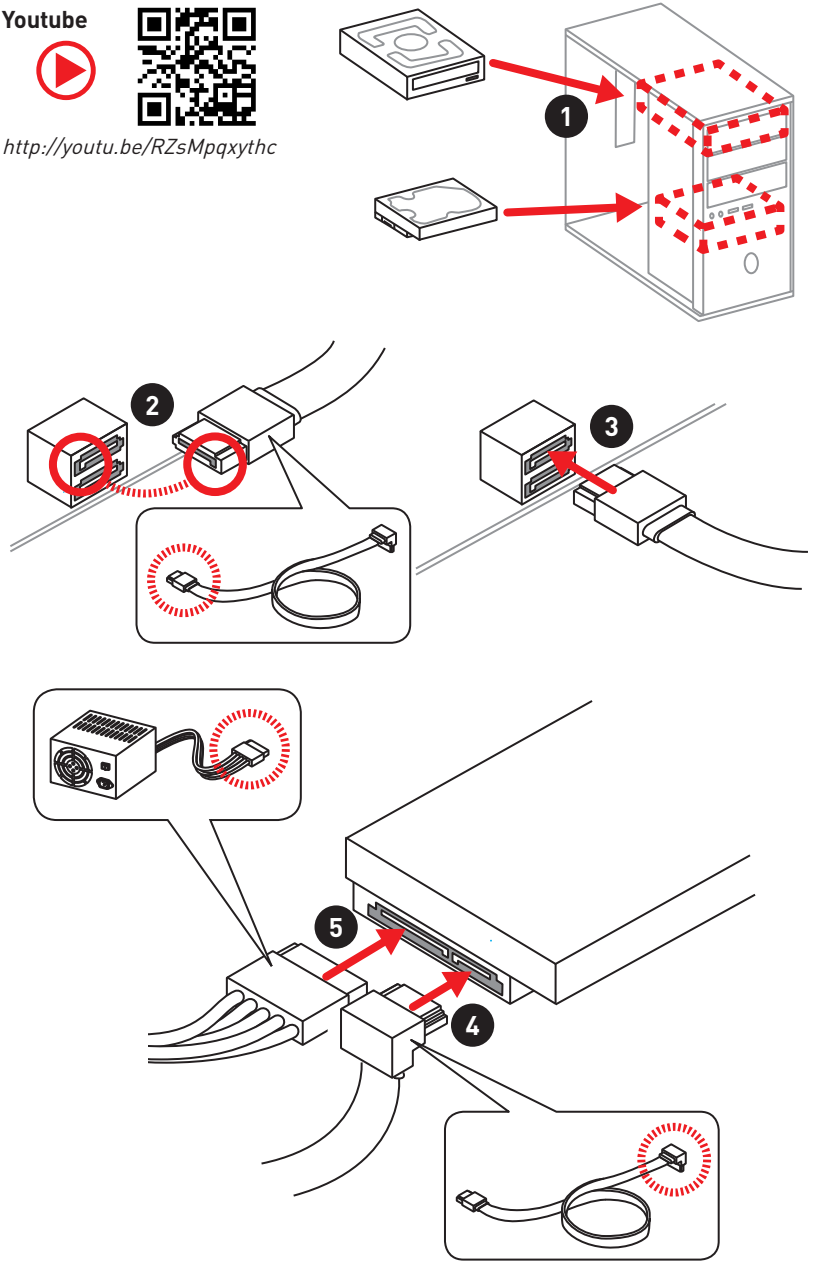




SATA 드라이브 설치하기

Youtube

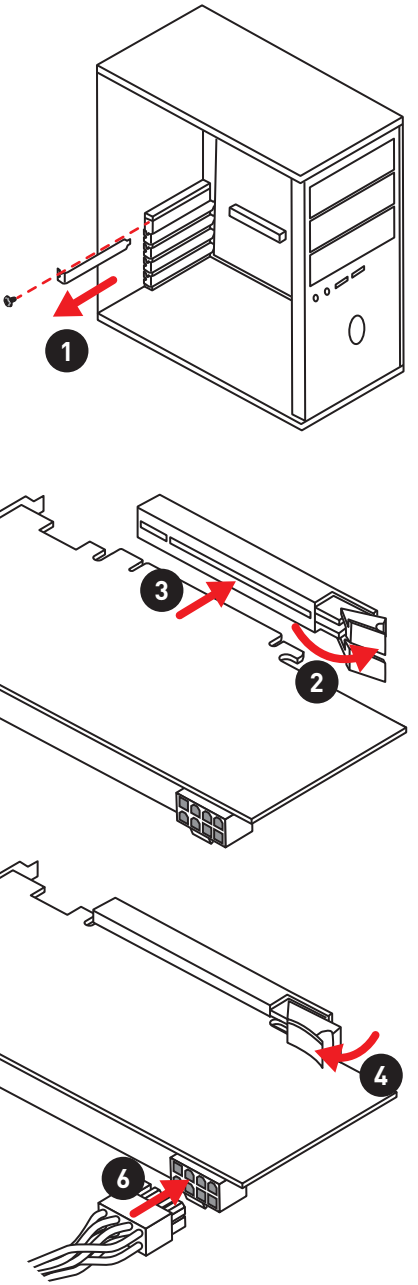
http://youtu.be/RZsMpqxythc



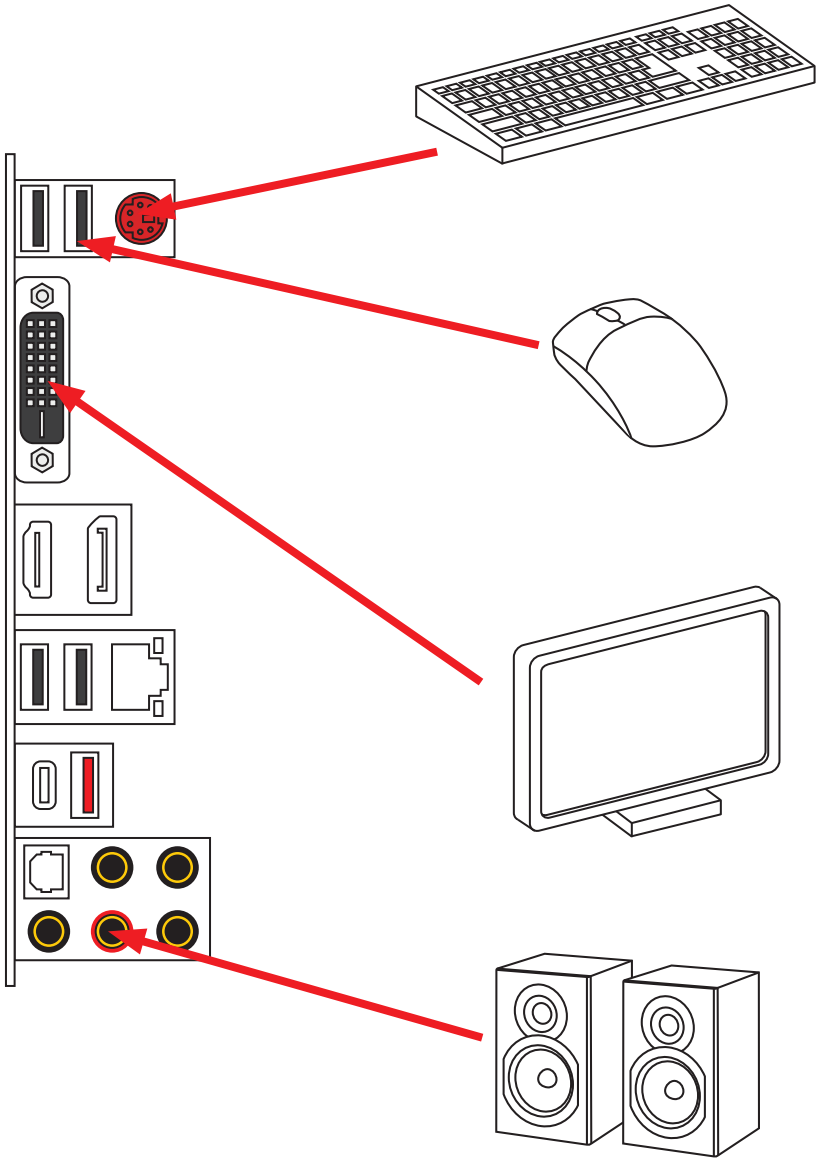
그래픽 카드 설치하기

Youtube

http://youtu.be/mG0GZpr9w_A



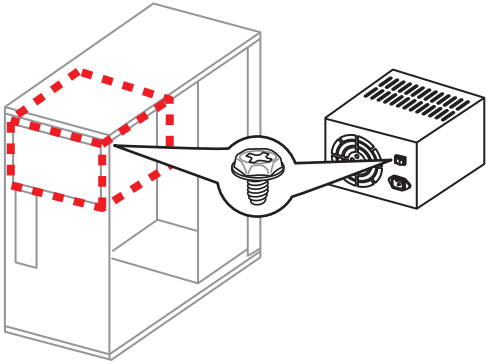
주변 장치 연결하기

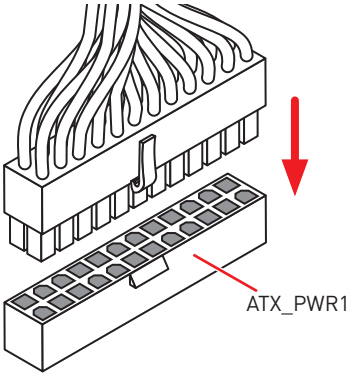


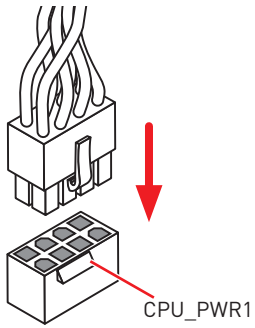
전원 커넥터 연결하기

Youtube

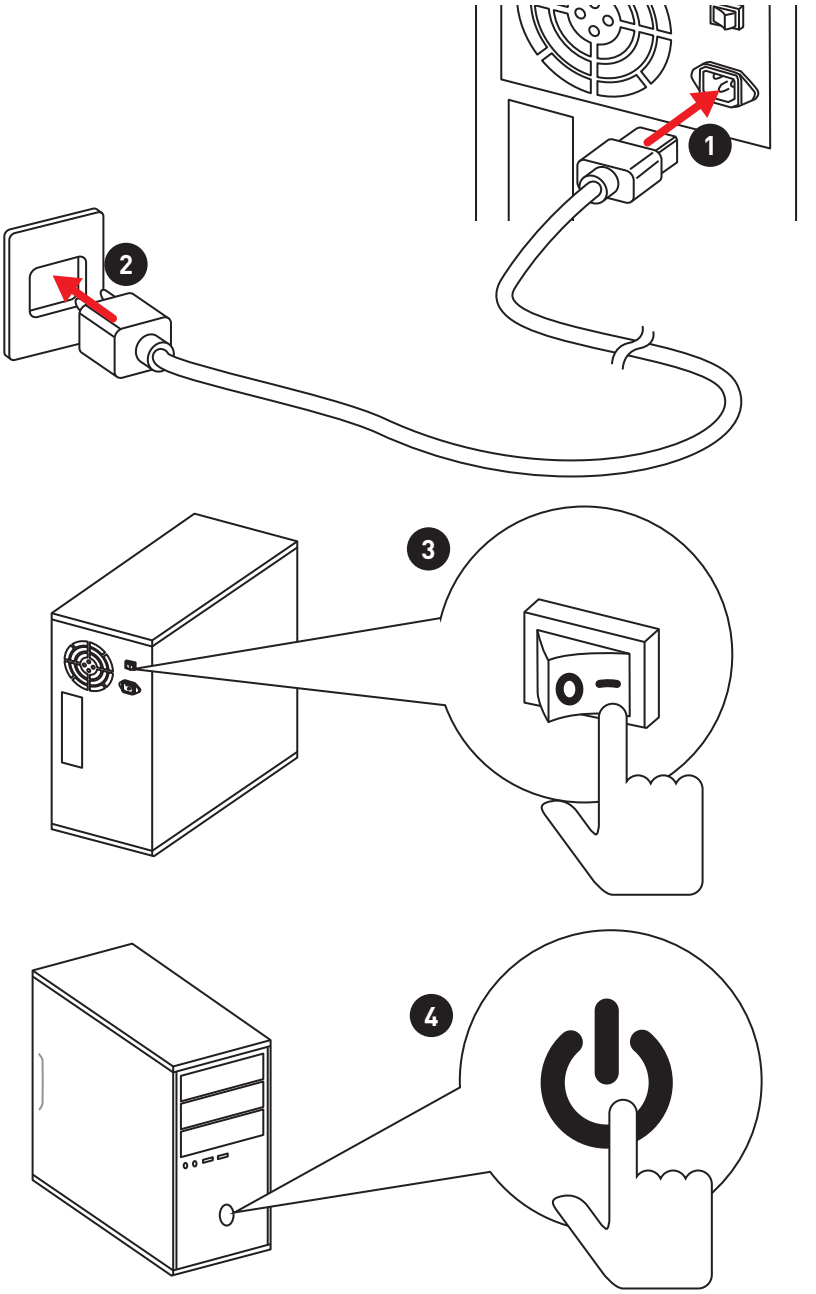
http://youtu.be/gkDYyR_83I4







전원 켜기



목차

안전 지침 **2**

사양 **3**

후면 I/O 패널 **7**

LAN 포트 LED 상태 표시 7

오디오 포트 구성 도표 7

Realtek HD 오디오 매니저 8

구성품 개요 **10**

CPU 소켓 11

DIMM 슬롯 12

PCI_E1~4: PCIe 확장 슬롯 13

SATA1~4: SATA 6Gb/s 커넥터 14

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터 14

M2_1: M.2 슬롯 (Key M) 15

CPU_PWR1, ATX_PWR1: 전원 커넥터 16

JAUD1: 전면 오디오 커넥터 16

JUSB1: USB 2.0 커넥터 17

JUSB2: USB 3.1 Gen1 커넥터 17

CPU_FAN1, SYS_FAN1~3: 팬 커넥터 18

JCI1: 섀시 침입 커넥터 19

JTPM1: TPM 모듈 커넥터 19

JRGB1: RGB LED 커넥터 20

JTBT1: 썬더볼트 추가 카드 커넥터 20

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼 21

EZ 디버그 LED 21

BIOS 설정 **22**

BIOS 설정 22

BIOS(바이오스) 리셋하기 23

BIOS(바이오스) 업데이트하기 23

EZ 모드 24

고급 모드 26

OC 메뉴 27

소프트웨어 설명 **32**

Windows® 10 운영 체제 설치하기 32

드라이버 설치하기 32

유틸리티 설치하기 32

안전 지침

• 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하기 바랍니다.

• 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤 수가 없게 됩니다.

• 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡기 바랍니다.

• 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 ESD 손목 스트랩을 착용할 것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하시기 바랍니다.

• 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하기 바랍니다.

• 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인합니다.

• 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마세요. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.

• 설치시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하시기 바랍니다.

• 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.

• 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관해두세요.

• 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마세요.

• PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하세요.

• 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하세요. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마세요.

• 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하기 바랍니다.

• 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으세요.

  ▪ 액체가 장치 안에 스며들었습니다.

  ▪ 메인보드가 습기에 노출되었습니다.

  ▪ 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.

  ▪ 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.

  ▪ 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.

• 메인보드를 주변온도 60°C (140°F) 이상에 두지 마세요. 메인보드가 손상될 수 있습니다.

사양

CPU	소켓 LGA1151 용 8 세대 인텔® 코어™ 및 펜티엄® 골드와 셀러론® 프로세서 지원
칩셋	Intel® B360 칩셋
메모리	• DDR4 메모리 슬롯 4개, 최대 64GB 지원 • DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz 지원 • 듀얼 채널 모드 지원 • non-ECC, un-buffered 메모리 지원 • Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 지원 * 호환되는 메모리에 대한 최신 정보는 http://www.msi.com을 참조하십시오.
확장 슬롯	• PCIe 3.0 x16 슬롯 2개 (x16/x4 모드 지원) • PCIe 3.0 x1 슬롯 2개
온보드 그래픽	• DVI-D 1포트, 최대 1920x1200@60Hz 해상도 지원 • DisplayPort 1포트 1.2, 최대 4096X2304@60Hz 해상도 지원 • HDMI™ 1포트 1.4, 최대 4096x2160@30Hz 해상도 지원
스토리지	Intel® B360 칩셋 • SATA 6Gb/s 4포트 • M.2 슬롯 1개 (Key M) ▪ M2_1는 최대 PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280 저장 장치* 를 지원합니다. ▪ Intel® Optane™ Memory Ready** * PCIe 장치가 PCI_E4 슬롯에 설치된 경우 M2_1 슬롯을 사용할 수 없습니다. ** Intel® Optane™ 메모리 모듈을 사용하기 전, 웹사이트에서 최신 버전의 드라이버와 BIOS 를 업데이트 하였는지 확인하시기 바랍니다.
USB	Intel® B360 칩셋 • USB 3.1 Gen2 (슈퍼 스피드 USB 10Gbps) 2포트 (C타입 1개와 후면 패널에 A타입 포트 1개) • USB 3.1 Gen1 (슈퍼 스피드 USB) 내장 USB 커넥터를 통해 2개 • USB 2.0 (하이 스피드 USB) 6포트 (후면 패널에 A타입 4포트, 내장 USB 커넥터를 통해 2포트)

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

오디오	• Realtek® ALC892 코덱 • 7.1-채널 HD 오디오 • S/PDIF 출력 지원
LAN	Intel I219-V Gigabit LAN 컨트롤러 1개
후면 패널 커넥터	• PS/2 키보드/ 마우스 콤보 포트 1개 • DVI-D 포트 1개 • DisplayPort 포트 1개 • HDMI 포트 1개 • LAN (RJ45) 포트 1개 • USB 2.0 A타입 포트 4개 • USB 3.1 Gen2 A타입 포트 1개 • USB 3.1 Gen2 C타입 포트 1개 • OFC 오디오 잭 5개 • 옵티컬 S/PDIF 출력 커넥터 1개
내장 커넥터	• 24핀 ATX 메인 전원 커넥터 1개 • 8핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개 • SATA 6Gb/s 커넥터 4개 • USB 3.1 Gen1 커넥터 1개 (외 USB 3.1 Gen1 2포트 지원) • USB 2.0 커넥터 1개 (외 USB 2.0 2포트 지원) • 4핀 CPU 팬 커넥터 1개 • 4핀 시스템 팬 커넥터 3개 • 전면 패널 오디오 커넥터 1개 • 전면 패널 커넥터 2개 • 12V 5050 RGB LED 스트립 커넥터 1개 • 썬더볼트 추가 카드 커넥터 1개 • TPM 모듈 커넥터 1개 • 섀시 침입 커넥터 1개 • CMOS클리어 점퍼 1개
I/O 컨트롤러	NUVOTON NCT6797 컨트롤러 칩

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

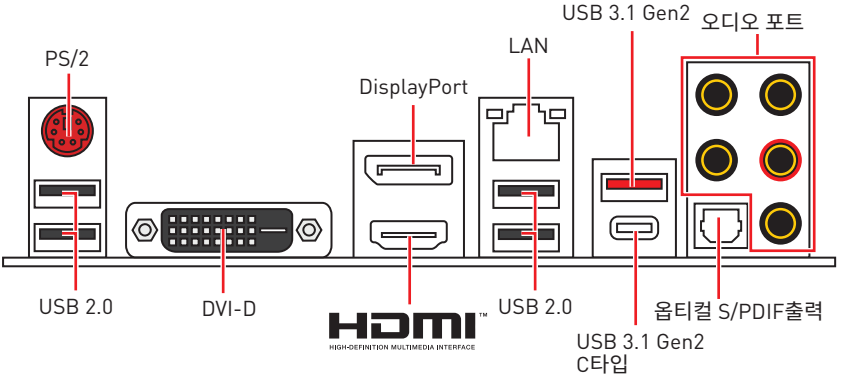
하드웨어 모니터	• CPU/시스템 온도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 제어
폼 팩터	• Micro-ATX 폼 팩터 • 9.6 in. x 9.6 in. (24.3 cm x 24.3 cm)
BIOS 기능	• 128 Mb 플래시 1개 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.1, SMBIOS 2.8 • 다국어
소프트웨어	• 드라이버 • 앱 매니저 • 커맨드 센터 • 라이브 업데이트 6 • 스마트 툴 • 램 디스크 • DPC 레이턴시 튜너 • 패스트 부트 • X-부스트 • 게이밍 APP • 슈퍼 차져 • 미스틱 라이트 • 게이밍 LAN 매니저 • 나히믹 오디오 • Open Broadcaster Software (OBS) • CPU-Z MSI 게이밍 • 인텔® 익스트림 튜닝 유틸리티 • 구글 유틸리티 : 크롬, 툴바, 드라이브 • 노턴™ 인터넷 시큐리티 솔루션 * 이 제공은 제한된 기간 동안만 유효합니다. 자세한 내용은 www.msi.com를 참조하십시오.

다음 페이지에서 계속

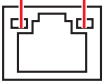
이전 페이지로부터 계속

특수 기능	• 오디오 ▪ 오디오 부스트 ▪ 나히믹 2.5 ▪ 보이스 부스트 • 네트워크 ▪ 게이밍 LAN과 게이밍 LAN 매니저 • 저장 장치 ▪ 터보 M.2 ▪ Intel® Optane Memory Ready • 팬 ▪ 스마트 팬 컨트롤 • LED ▪ 미스틱 라이트 ▪ 미스틱 라이트 익스텐션 (JRGB) ▪ 미스틱 라이트 싱크 ▪ EZ 디버그 LED • 보호 ▪ PCIe 스틸 아머 • 성능 ▪ 멀티 GPU – 크로스 파이어 기술 ▪ DDR4 부스트 ▪ USB A+C타입 ▪ 인텔 터보 USB 3.1 Gen 2 • 안전성 ▪ 7000+ 품질 테스트 • VR ▪ VR Ready • 게이머 익스피리언스 ▪ 게이밍 핫키 ▪ 게이밍 마우스 컨트롤 • BIOS ▪ 클릭 BIOS 5 • 인증 ▪ GAMING Certified

후면 I/O 패널



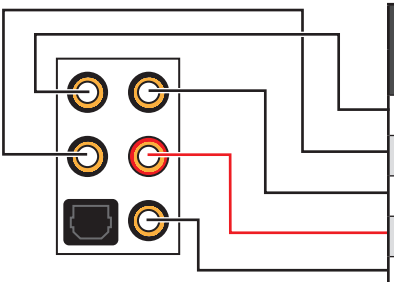
LAN 포트 LED 상태 표시



링크/ 통신 LED	
상태	설명
꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
깜박임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.

속도 LED	
상태	설명
꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.

오디오 포트 구성 도표



오디오 포트	채널			
	2	4	6	8
중앙/ 서브우퍼 출력			●	●
뒷면 스피커 출력		●	●	●
라인 입력/ 사이드 스피커 출력				●
라인 출력/ 전면 스피커 출력	●	●	●	●
마이크 입력				

(●: 연결됨, **Blank**: 무)

Realtek HD 오디오 매니저

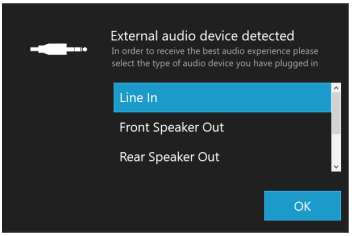
Realtek HD 오디오 드라이버를 설치한 후 **Realtek HD Audio Manager** 아이콘이 시스템 트레이에 나타나면 두 번 클릭하여 이 항목을 실행합니다.



- **장치 선택** - 오디오 출력 소스를 선택하여 관련 옵션을 변경합니다. 체크 표시된 장치가 기본 장치입니다.
- **애플리케이션 강화** - 출력 및 입력 장치의 예상 음향 효과에 대한 가이드를 전부 제공합니다.
- **메인 볼륨** - 바를 조정하여 볼륨을 조정하거나 전면 또는 후면 패널에 연결된 스피커의 오른쪽/왼쪽 사이드의 균형을 잡습니다.
- **프로파일** - 프로파일 사이에서 전환합니다.
- **고급 설정** - 2개의 독립적인 오디오 스트림을 처리하는 메커니즘을 제공합니다.
- **잭 상태** - 모든 렌더링 및 캡처 장치가 현재 컴퓨터에 연결되었는지 보여줍니다.
- **커넥터 설정** - 커넥터 연결에 대한 설정을 구성합니다.

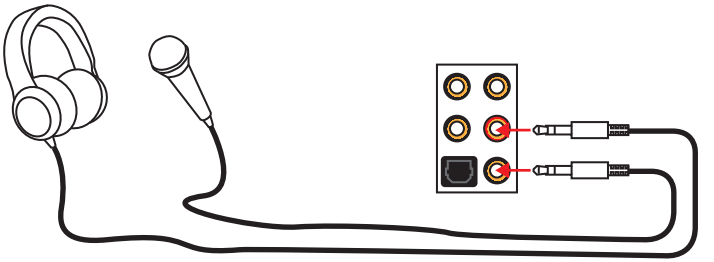
자동 팝업 대화창

장치를 오디오 잭에 연결하면 아래와 같은 대화창이 나타나며 현재 어떤 기기가 연결되었는지를 선택해야 합니다.

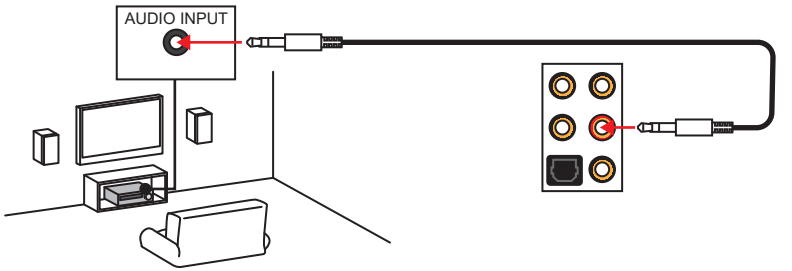


다음 페이지에서 각 잭에 해당하는 기본 설정을 알아볼 수 있습니다.

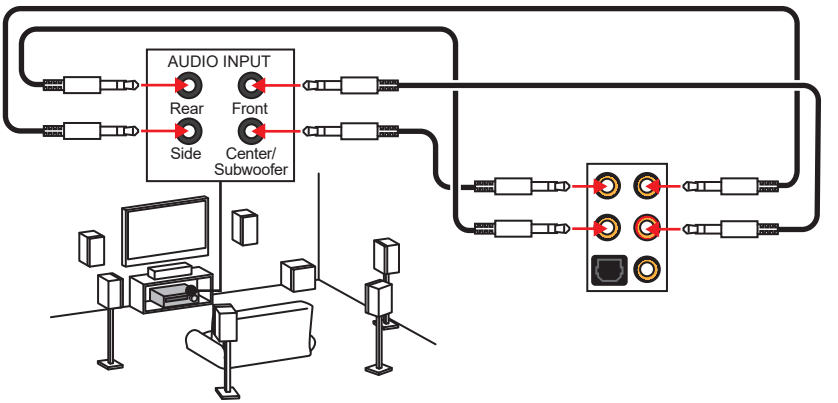
헤드폰 및 마이크용 오디오 잭 도표



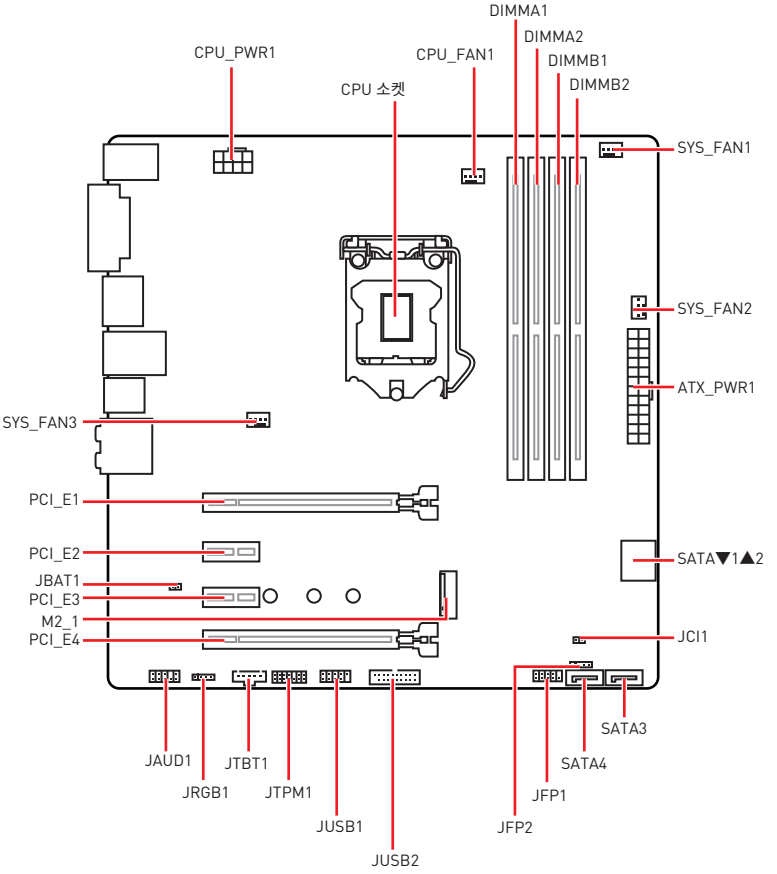
스테레오 스피커용 오디오 잭 도표



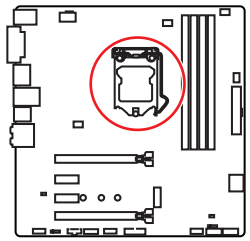
7.1-채널 스피커용 오디오 잭 도표

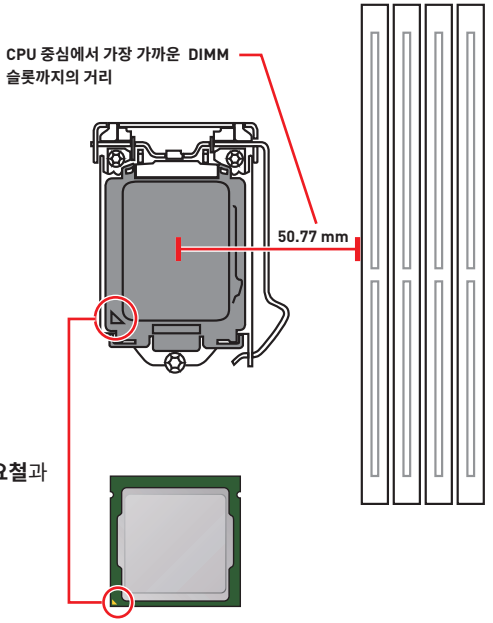


구성품 개요


DIMMA1
DIMMA2
DIMMB1
DIMMB2
CPU_PWR1
CPU_FAN1
CPU 소켓
SYS_FAN1
SYS_FAN2
ATX_PWR1
SYS_FAN3
PCI_E1
PCI_E2
JBAT1
PCI_E3
M2_1
PCI_E4
SATA▼1▲2
JCI1
SATA3
SATA4
JFP1
JFP2
JAUD1
JRGB1
JTBT1
JTPM1
JUSB1
JUSB2

CPU 소켓





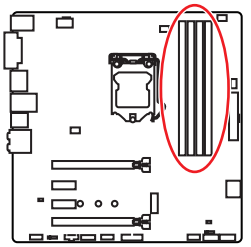
LGA 1151 CPU 소개

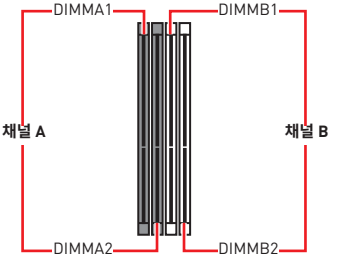
메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA1155 CPU 표면에 2개의 **요철**과 하나의 **금색 삼각형**이 있습니다. 금색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.

중요사항

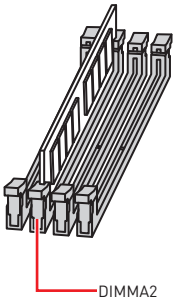
- *CPU를 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주시기 바랍니다.*
- *프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하시기 바랍니다. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청 처리를 진행할 수 있습니다.*
- *CPU 설치시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.*
- *시스템을 부팅하기 전에 CPU 히트싱크가 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주세요.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU와 히트싱크/ 쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/ 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.*
- *이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다. 오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요. 제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품 스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.*

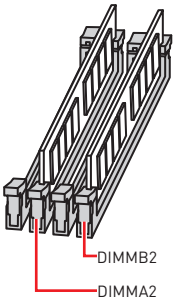
DIMM 슬롯

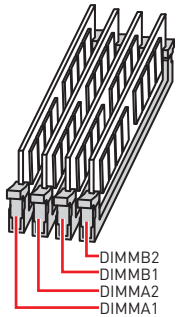




메모리 모듈 설치 (추천)



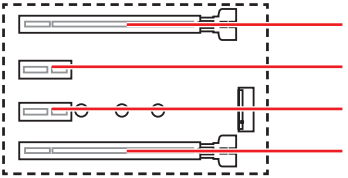




중요사항

- *항상 **DIMMA2** 슬롯에 메모리 모듈을 먼저 삽입하세요.*
- *칩셋 자원 사용법에 의해 사용 가능한 메모리의 용량은 설치된 용량보다 작습니다.*
- *CPU 사양의 기초하에 CPU 보호를 위해 메모리 DIMM 전압은 1.35V 이하로 제안합니다.*
- *주소 메모리의 최대 용량은 4GB 혹은 메모리 주소 제한으로 인해 32-비트 (Windows OS) 이하 라는 것을 유의하세요. 따라서 메인 보드에 4GB이상 메모리를 설치하려면 64-비트 Windows OS를 설치할 것을 권장합니다.*
- *메모리 주파수는 직렬 작동으로 인해 오버클러킹시 일부 메모리는 표시된 값보다 낮은 주파수에서 작동하게 됩니다. 메모리 주파수는 Serial Presence Detect (SPD)에 의해 작동하기 때문에 오버클로킹시 일부 메모리는 표시된 값보다 낮은 주파수로 작동합니다. 표시된 값 또는 더욱 높은 주파수에서 메모리를 작동하려면 BIOS로 이동한 후 **Memory Try It!** 에서 메모리 주파수를 설정하세요.*
- *풀 DIMM 설치 또는 오버클로킹을 위해 보다 효율적으로 메모리 냉각 시스템을 사용할 것을 권장합니다.*
- *오버클로킹시의 안정성과 설치된 메모리 모듈의 호환성은 설치된 CPU 및 장치에 따라 달라집니다.*

PCI_E1~4: PCIe 확장 슬롯



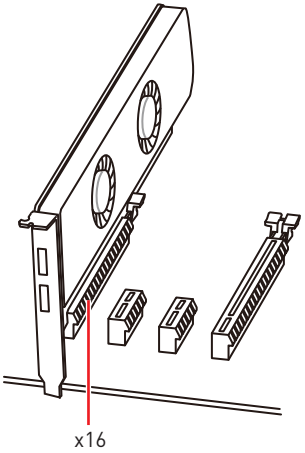
PCI_E1: PCIe 3.0 x16 (CPU 레인)

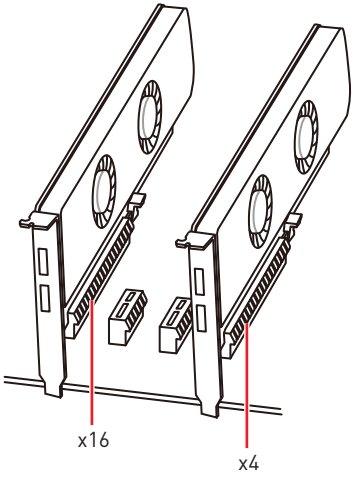
PCI_E2: PCIe 3.0 x1 (PCH 레인)

PCI_E3: PCIe 3.0 x1 (PCH 레인)

PCI_E4: PCIe 3.0 x4 (PCH 레인)

여러 개의 그래픽 카드 설치 (추천)



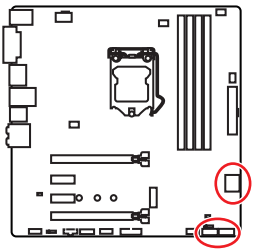


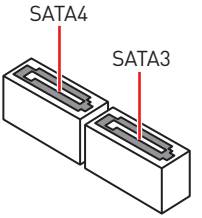
중요사항

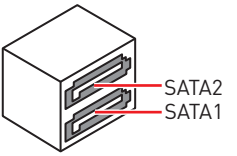
- *크고 무거운 그래픽 카드를 설치할 경우, 그래픽 카드를 안전하게 지지하여 슬롯의 변형을 방지하기 위해 **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster**와 같은 도구를 사용하시기 바랍니다.*
- *하나의 PCIe x16 확장 카드를 설치하여 최적의 효과를 원하신다면 **PCI_E1** 슬롯을 사용할 것을 추천합니다.*
- *확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.*

SATA1~4: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다





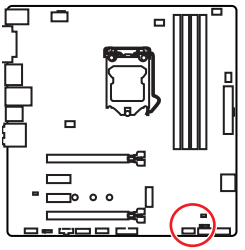


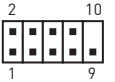
중요사항

- *SATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만. 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.*

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널에 있는 스위치 및 LED를 연결할 수 있습니다.





JFP1

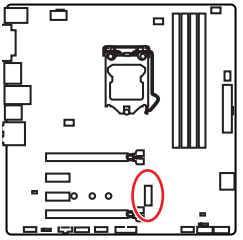
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin



JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +

M2_1: M.2 슬롯 (Key M)



중요사항

- *Intel® RST는 PCIe M.2 SSD UEFI ROM만 지원합니다.*
- *Intel® Optane™ Memory Ready.*
- *PCIe 장치가 PCI_E4 슬롯에 설치된 경우 M2_1 슬롯은 사용할 수 없습니다.*
- *M2_1 슬롯은 PCIe모드만 지원합니다.*

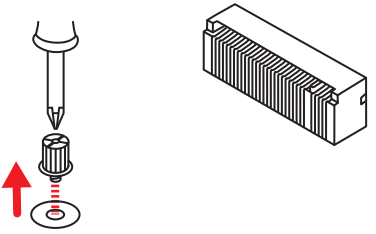
데모 동영상

M.2 SSD를 설치하는 방법을 알아보려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

http://youtu.be/JCTFABytrYA

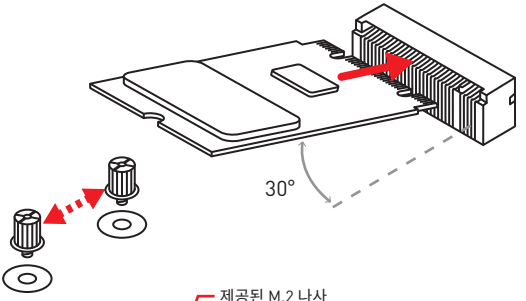
M.2 SSD 설치하기

1. 메인보드에서 M.2 라이저 나사를 풀어줍니다.

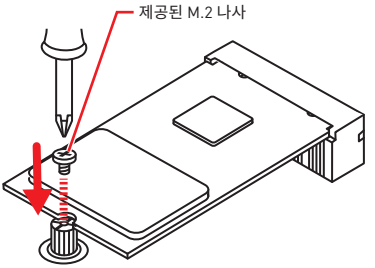


2. M.2 라이저 나사를 M.2 SSD의 적절한 장소로 이동하여 고정하십시오.

3. 30도 각도로 M.2 SSD를 M.2 슬롯에 삽입합니다.

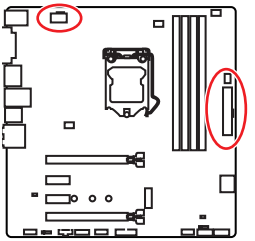


4. 제공된 M.2 나사로 M.2 SSD를 제자리에 고정합니다.



CPU_PWR1, ATX_PWR1: 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.



8 4 5 1 CPU_PWR1

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

12 24 ATX_PWR1 1 13

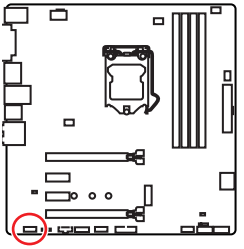
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground

중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하십시오.

JAUD1: 전면 오디오 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.

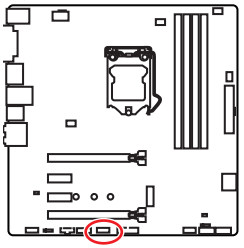


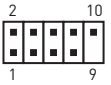
2 10 1 9

1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JUSB1: USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 2.0 포트를 연결할 수 있습니다.





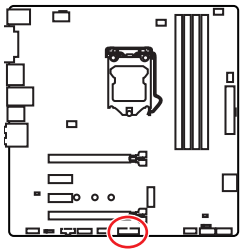
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

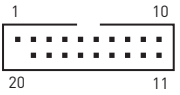
중요사항

- *VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *USB 포트를 통하여 iPad,iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI® SUPER CHARGER 유틸리티를 설치하십시오.*

JUSB2: USB 3.1 Gen1 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.1 Gen1 포트를 연결할 수 있습니다.





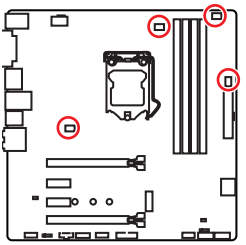
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

중요사항

전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.

CPU_FAN1, SYS_FAN1~3: 팬 커넥터

팬 커넥터는 PWM (Pulse Width Modulation) 모드와 DC 모드로 분류될 수 있습니다. PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. DC 모드 팬 커넥터는 전압의 변화에 따라 팬의 회전 속도를 제어합니다. 만일 PWM 모드 팬 커넥터에 3-핀 (Non-PWM) 팬을 연결하였을 경우, 팬은 100% 속도로 회전하기 때문에 잡음이 많이 생길 수 있습니다.다음 설명에 따라 팬 커넥터를 PWM 또는 DC 모드로 조정하세요.



PWM 모드 팬 커넥터



CPU_FAN1

DC 모드 팬 커넥터



SYS_FAN1/SYS_FAN3

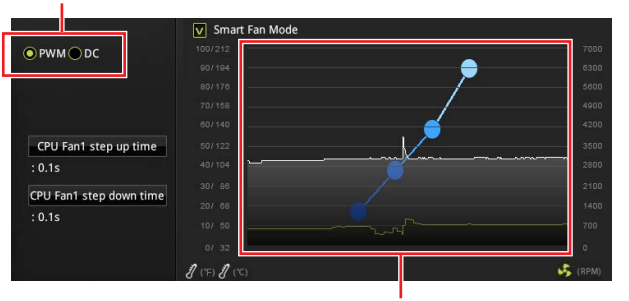


SYS_FAN2

팬 모드 전환 및 속도 조정

PWM 모드와 DC 모드 사이에서 전환할 수 있으며 **BIOS > HARDWARE MONITOR(하드웨어 모니터)**로 이동하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다.

PWM 모드 또는 **DC** 모드 선택



CPU 온도에 따라 팬 속도를 단계별 설정 가능합니다.

중요사항

PWM/ DC 모드로 전환한 후, 팬이 제대로 작동하는지 확인하시기 바랍니다.

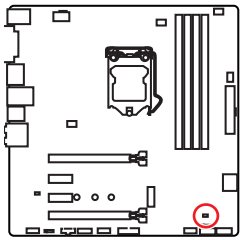
팬 커넥터 핀 정의

PWM 모드 핀 정의			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 모드 핀 정의			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터를 사용하여 섀시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.





표준 상태

(기본 설정)



섀시 침입 이벤트 트리거

섀시 침입 탐지기 사용하기

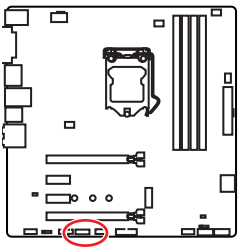
1. **JCI1**커넥터를 섀시의 섀시 침입 스위치/ 센서에 연결합니다.
2. 섀시 커버를 닫습니다.
3. **BIOS > Settings(설정) > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)**으로 이동합니다.
4. **Chassis Intrusion(섀시 침입)** 항목을 **Enabled(사용)**으로 설정합니다.
5. **F10** 키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. **Enter** 키를 누른 후 **Yes**를 선택합니다.
6. 섀시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 알람 메시지가 화면에 나타납니다.

섀시 침입 알람 재설정하기

1. **BIOS > Settings(설정) > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(섀시 침입 구성)**으로 이동합니다.
2. **Chassis Intrusion(섀시 침입)**을 **Reset(리셋)**으로 설정합니다.
3. **F10** 키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. **Enter**키를 누른 후 **Yes**를 선택합니다.

JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용방법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

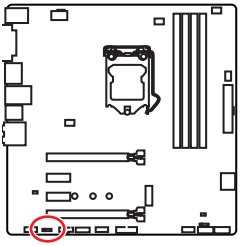


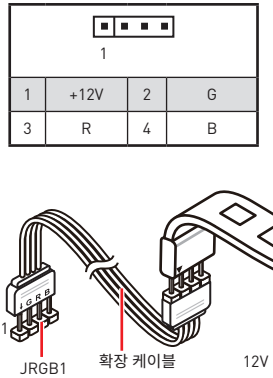


1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JRGB1: RGB LED 커넥터

이 커넥터를 사용하여 12V의 5050 RGB LED 스트립을 연결할 수 있습니다.





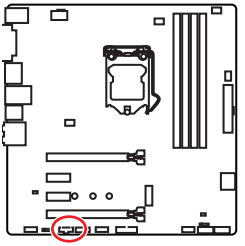
1	+12V	2	G
3	R	4	B

중요사항

- *JRGB1 커넥터는 최대 3A (12V) 정격 전력에서 5050 RGB LED 스트립 (12V/G/R/B)을 지원합니다.*
- *LED 밝기가 약해질 수 있으므로 스트랩의 길이가 2m보다 작아야 합니다.*
- *RGB LED 스트립을 설치 또는 제거하기 전에 항상 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주세요.*
- *MSI 소프트웨어를 사용하여 확장된 LED 스트립을 조정하세요.*

JTBT1: 썬더볼트 추가 카드 커넥터

이 커넥터를 사용하여 추가 썬더볼트 입/출력(I/O) 카드에 연결합니다.

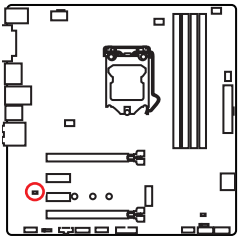




1	FORCE_PWR	2	SCI_EVENT
3	SLP_S3#	4	SLP_S5#
5	GND		

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우세요.



데이터 유지
(기본 설정)

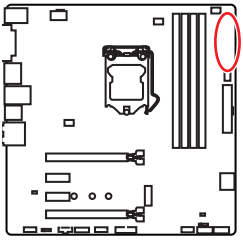
CMOS 클리어/
BIOS 리셋

기본 값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다
2. 점퍼 캡을 사용하여 JBAT1을 5-10초간 단락합니다.
3. JBAT1에서 점퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.

EZ 디버그 LED

이 LED는 메인보드의 디버그 상태를 나타냅니다.



- **CPU** - CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- **DRAM** -DRAM가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- **VGA** - GPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- **BOOT** - 부팅 장치가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.

BIOS 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지**하기 바랍니다.

중요사항

- *BIOS 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하십시오. 또한 BIOS 항목에 대해서는 **HELP(도움말)**의 설명을 참고할 수 있습니다.*
- *여기에 제공된 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 제품에 따라 다를수 있습니다.*

BIOS 설정

아래의 방법을 참조하여 BIOS 설정으로 이동하십시오.

- 부팅 과정에서 화면에 **DEL 키를 눌러 설정 메뉴로, F11 키를 눌러 부팅메뉴로 이동**이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.

- **MSI FAST BOOT MSI 패스트 부트** 애플리케이션을 사용하십시오. **GO2BIOS** 버튼을 클릭한 후 **OK(확인)**를 선택하십시오. 시스템이 재부팅되며 BIOS 설정으로 직접 이동하게 됩니다.



클릭 **GO2BIOS**

기능키

F1: 도움말

F2: 즐겨찾기 항목 추가/삭제

F3: 즐겨찾기 메뉴로 이동

F4: CPU 규격 메뉴로 이동

F5: Memory-Z(메모리-Z) 메뉴로 이동

F6: 최적의 기본값 불러오기

F7: 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환

F8: 오버클로킹 프로파일 로드

F9: 오버클로킹 프로파일 저장

F10: 변경값 저장 및 리셋*

F12: 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장(FAT/FAT32 포맷 전용)

Ctrl+F: 검색 페이지로 이동

*F10 키를 누르면 확인 대화창이 나타나며 변경사항에 대한 정보를 제공합니다. Yes(예) 또는 No(아니요)를 클릭하여 선택을 확인합니다.

BIOS(바이오스) 리셋하기

문제 해결을 위해 BIOS(바이오스)기본 설정을 복원해야할 경우가 나타날 수 있습니다. BIOS(바이오스)를 리셋하는 방법에는 다음과 같은 몇 가지가 있습니다.:

- BIOS(바이오스)로 이동한 후 **F6 키**를 눌러 최적화된 기본값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어 점퍼**버튼을 단락시킵니다.

중요사항

*CMOS 데이터를 삭제하기 전에 컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. BIOS(바이오스)를 재설정하려면 **CMOS 클리어** 점퍼 섹션을 참조하십시오.*

BIOS(바이오스) 업데이트하기

M-FLASH로 BIOS(바이오스) 업데이트하기

업데이트하기 전:

구입한 메인보드 모델에 맞는 최신 BIOS(바이오스) 파일을 MSI 웹사이트에서 다운로드한 후 그런 다음, BIOS(바이오스)파일을 USB 플래시 드라이브의 루트 폴더에 저장하십시오.

BIOS(바이오스) 업데이트하기:

1. 업데이트 파일이 들어있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.
2. POST 하는 동안 **<Ctrl+F5>**키를 눌러줍니다.
3. **Yes**를 클릭하여 시스템을 재부팅한 후 플래시 모드로 이동합니다.
4. BIOS 파일을 선택하여 BIOS 업데이트 프로세서를 진행합니다.
5. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

Live Update 6으로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전:

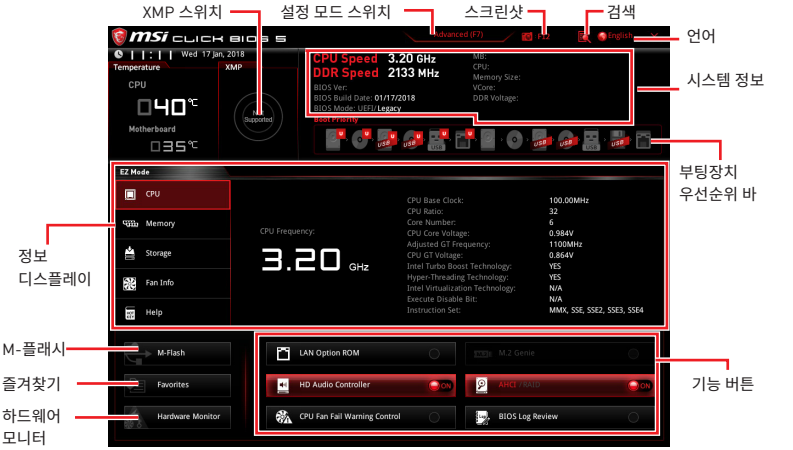
LAN 드라이버가 이미 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하세요.

BIOS(바이오스) 업데이트하기:

1. MSI LIVE UPDATE 6을 설치 및 시작합니다.
2. **BIOS Update**를 선택합니다.
3. **Scan** 버튼을 클릭합니다.
4. **Download** 아이콘을 클릭하여 최신 BIOS 파일을 다운로드한 후 설치합니다.
5. **Next**를 클릭하고 **In Windows mode**를 선택한 후 **Next** 및 **Start**를 클릭하여 BIOS를 업데이트하기 시작합니다.
6. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

EZ 모드

EZ 모드는 시스템의 기본 정보를 제공하고 시스템의 기본 설정을 구성할 수 있습니다. 고급 BIOS 설정을 구성하려면 **설정 모드 스위치** 또는 **F7** 기능 키를 눌러 고급 모드로 이동하십시오.



• **XMP 스위치** - 안쪽 원을 클릭하여 X.M.P. (Extreme Memory Profile) 기능을 활성화/비활성화합니다 바깥 원으로 전환하여 X.M.P. 프로파일을 선택합니다. 이 스위치는 X.M.P.를 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.

• **설정 모드 스위치** - 이 탭 또는 **F7** 키를 눌러 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환할 수 있습니다.

• **스크린샷** - 이 탭 또는 **F12** 키를 눌러 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장합니다 (FAT/FAT32 포맷 전용).

• **검색** - 이 탭을 클릭하거나 **Ctrl+F** 키를 동시에 누르면 검색 페이지가 나타납니다. BIOS 항목 이름으로 검색할 수 있으며 항목 이름을 입력하면 리스트가 나타납니다. 마우스를 빈 공간으로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 검색 페이지를 종료합니다.

중요사항

검색 페이지에서는 F6, F10 및 F12 기능 키만 사용 가능합니다.

• **언어** - BIOS 설정 시, 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

• **시스템 정보** - CPU/DDR 속도, CPU/MB 온도, MB/CPU 타입, 메모리 용량, CPU/DDR 전압, BIOS 버전 및 시스템 구축 날짜 등 정보를 표시합니다.

• **부팅 장치 우선순위 바** - 장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다. 왼쪽에서부터 오른쪽으로 가면서 낮아지는 순위입니다.

• **정보 디스플레이** - 왼쪽 부분의 **CPU, 메모리, 스토리지, 팬 정보** 및 **Help** 버튼을 클릭하면 관련 정보가 나타납니다.

• **기능 버튼** - 관련 키를 클릭하여 **LAN Option ROM, M.2/ Optane Genie, HD audio controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control** 및 **BIOS Log Review** 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

• **M-플래시** - 이 버튼을 클릭하면 **M-Flash** 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴는 USB 플래시 드라이브로 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공합니다.

• **하드웨어 모니터**- 이 버튼을 누르면 **Hardware Monitor** 메뉴가 나타나며 이 메뉴에서 퍼센트수로 팬 회전 속도를 수동으로 제어할 수 있습니다.

• **즐겨찾기** - **F3** 키를 눌러 **즐겨찾기** 메뉴로 이동합니다. BIOS 즐겨찾기 메뉴를 만들어 자주 사용하는 BIOS 설정 항목을 저장한 후 직접 액세스할 수 있습니다.

▪ **Default HomePage** - BIOS 메뉴 (예를 들어 설정, OC...등)을 선택하여 BIOS 홈페이지로 설정할 수 있습니다.

▪ **Favorite1~5** - 자주 사용하는 BIOS 설정 항목을 하나의 페이지에 추가할 수 있습니다.

▪ **즐겨찾기 페이지에 BIOS 항목을 추가하기 (Favorite 1~5)**

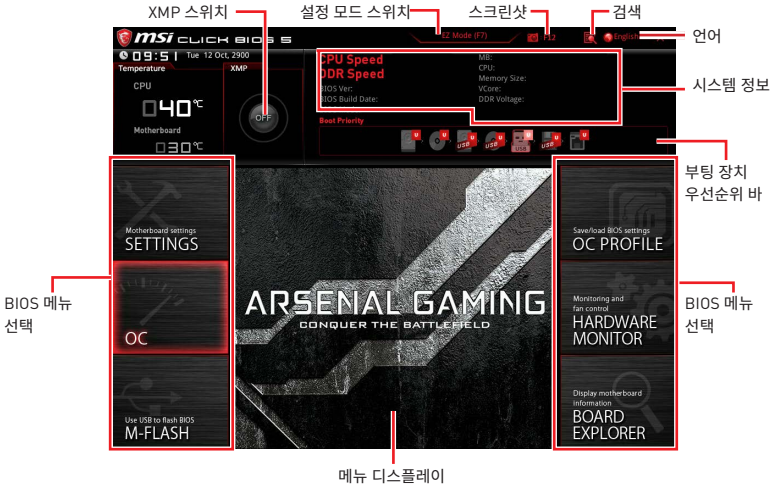
1. BIOS 메뉴 또는 검색 페이지에서 마우스를 BIOS 항목에 가져다 놓습니다.
2. 마우스의 오른쪽 버튼 또는 **F2** 키를 클릭합니다.
3. 즐겨찾기 페이지를 선택한 후 **OK**를 클릭합니다.

▪ **즐겨찾기 페이지에서 BIOS 항목 삭제하기**

1. 즐겨찾기 페이지에서 삭제하려는 BIOS 항목을 선택합니다. (Favorite 1~5)
2. 마우스의 오른쪽 버튼 또는 **F2** 키를 클릭합니다.
3. **Delete**를 선택한 후 **OK**를 클릭합니다.

고급 모드

설정 모드 스위치 또는 **F7** 기능 키를 누르면 EZ 모드와 고급 모드 사이에서 전환할 수 있습니다.



• **XMP 스위치/ 설정 모드 스위치/스크린샷/언어/시스템 정보/부팅 장치 우선순위 바** -EZ 모드 개요 부분의 내용을 참조하십시오.

• **BIOS 선택 메뉴** - 다음과 같은 옵션이 제공됩니다.:

  ▪ **SETTINGS(설정)** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 및 부팅 장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.

  ▪ **OC (오버클로킹)** - 이 메뉴를 사용하여 클럭 및 전압을 조정할 수 있습니다. 클럭이 높아지면 성능이 향상됩니다.

  ▪ **M-플래시** - 이 메뉴는 USB 플래시 드라이브로 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공합니다.

  ▪ **OC 프로파일** - 이 메뉴는 오버클로킹 프로파일을 설정하는 데 사용됩니다.

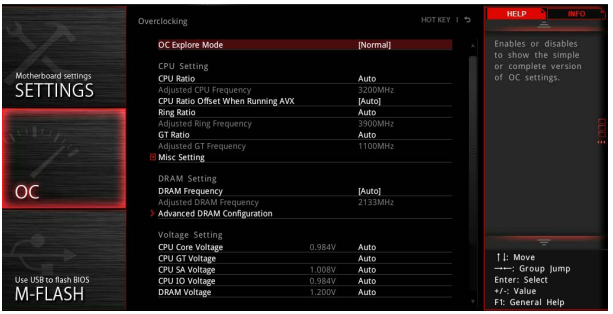
  ▪ **하드웨어 모니터**- 이 메뉴는 팬 속도를 설정하고 시스템 전압을 모니터링하는 데 사용됩니다.

  ▪ **BOARD EXPLORER(보드 탐색기)** - 이 메뉴는 메인보드에 설치된 장치의 정보를 제공합니다.

• **메뉴 디스플레이** - 이 메뉴는 BIOS 설정 및 구성 정보를 제공합니다.

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.



중요사항

- *이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.*
- *오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될 수 있습니다.*

▶ OC Explore Mode [Normal]

이 항목을 활성화 또는 비활성화하여 OC 설정의 일반 또는 고급 버전을 나타냅니다.

[Normal] 일반 OC 설정을 제공합니다.

[Expert] 고급 OC 설정을 제공하여 BIOS를 구성합니다.

참조: * 로 고급 모드의 OC 설정을 표시합니다.

▶ CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

설치된 경우 나타납니다.

[All Core] **CPU Ratio**를 활성화합니다. 모든 CPU 코어는 **CPU Ratio**에서 설정한 동일한 비율로 실행됩니다.

[Per Core] **Core X X of X xxxx MHz**를 활성화합니다. CPU 코어 비율을 각각 설정합니다.

[Turbo Ratio] **X-Core Ratio Limit**를 활성화합니다. 이 옵션은 이 기능을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▶ X-Core Ratio Limit [Auto]*

이 항목을 사용하여 여러 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Ratio Apply Mode(CPU 비율 적용 모드)**가 **Turbo Ratio (터보 비율)**에 설정된 경우에만 나타납니다.

▶ Adjusted CPU Frequency

이 항목은 조정된 CPU주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ Core X X of X xxxx MHz [Auto]*

이 항목을 사용하여 여러 액티브 코어의 CPU 비율을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 **CPU Ratio Apply Mode** (CPU 비율 적용 모드)가 **Per Core**에 설정된 경우에만 나타납니다.

▶ **CPU Ratio Offset When Running AVX [Auto]**

오프셋 값을 설정하여 CPU 배율을 낮춰 AVX 명령어세트(AVX instruction set)를 실행할 때 열 확산에 도움이 될 수 있습니다. "Auto"로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 해당 기능을 지원하는 CPU가 설치되어 있는 경우 나타납니다.

▶ **Ring Ratio [Auto]**

이 항목을 사용하여 링 비율을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▶ **Adjusted Ring Frequency**

이 항목은 조정된 통합 그래픽 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **GT Ratio [Auto]**

이 항목을 사용하여 통합 그래픽 비율을 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 범위는 설치된 CPU에 따라 달라집니다.

▶ **Adjusted GT Frequency**

이 항목은 조정된 통합 그래픽 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **Misc Setting***

Enter, + 또는 - 키를 눌러 CPU 기능과 관련된 다음 2개의 항목을 활성화 또는 비활성화 합니다.

▶ **EIST [Enabled]***

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화 합니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 기본 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 자동으로 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel Turbo Boost [Enabled]***

이 항목을 사용하여 Enhanced Intel® SpeedStep Technology를 활성화 또는 비활성화 합니다.

[Enabled] 시스템이 최고 상태의 성능을 요구하는 경우, 이 기능을 활성화하여 기본 스펙 이상의 성능으로 CPU 클럭을 자동으로 올립니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled]**

X.M.P. (Extreme Memory Profile) 는 메모리 모듈을 사용하는 오버클로킹 기술입니다. XMP를 활성화하거나 메모리 모듈의 프로파일을 선택하여 메모리를 오버클럭할 수 있습니다. 이 항목은 X.M.P. 기술을 지원하는 메모리 모듈이 설치된 경우 사용할 수 있습니다.

▶ **DRAM Reference Clock [Auto]***

이 항목을 사용하여 DRAM 참조 클럭을 설정할 수 있습니다. 유효한 값 범위는 설치된 CPU에 따라 달라지며 본 항목은 이 조정을 지원하는 CPU가 설치된 경우에만 나타납니다.

▶ **DRAM Frequency [Auto]**

이 항목은 DRAM 클럭을 조정할 수 있습니다. 단, 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▶ **Adjusted DRAM Frequency**

이 항목은 조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

▶ **Memory Try It ! [Disabled]**

이 기능은 최적의 메모리 프리셋을 선택하여 메모리 호환성 또는 성능을 향상시켜 줍니다.

▶ **DRAM Timing Mode [Link]**

이 항목을 사용하여 메모리 타이밍 모드를 선택합니다.

[Link] 모든 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

[UnLink] 각 메모리 채널의 DRAM 타이밍을 수동으로 설정할 수 있습니다.

▶ **Advanced DRAM Configuration**

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 사용자는 메모리의 각 채널에 대해 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 점퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS 에서 기본 설정을 로드하세요.)

▶ **Memory Fast Boot [Auto]***

매번 부팅할 때 메모리의 트레이닝 개시를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 메모리는 첫번째 시작과 첫 트레이닝을 완전히 모방합니다.이후에 시스템 부팅 시간을 가속화하면서 부팅 할 경우, 메모리는 트레이닝되지 않습니다.

[Disabled] 메모리가 매번 부팅시 시작되거나 트레이닝됩니다.

▶ **CPU Voltages control [Auto]**

이 옵션 항목을 사용하여 CPU 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ **DRAM Voltages control [Auto]**

이 옵션 항목을 사용하여 메모리 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 또는 메모리가 교체되었을 경우, 시스템 부팅시 경고 메시지가 나타날지를 결정합니다.

[Enabled] 부팅시 경고 메시지가 나타나며 새 장치에 필요한 기본 값을 로드해야 합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화하는 동시에 현재 BIOS 설정을 유지합니다.

▶ **CPU Specifications**

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU의 정보를 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할 수 있습니다.(읽기 전용)

▶ **CPU Technology Support**

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 주요 기능을 표시합니다. (읽기 전용)

▶ **MEMORY-Z**

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다.사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

▶ **DIMMA1/A2/B1/B2 Memory SPD**

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.(읽기 전용)

▶ **CPU Features**

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ **Hyper-Threading [Enabled]**

실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산 능력을 극대화할 수 있습니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 설정을 지원하는 경우 나타납니다

[Enable] Intel Hyper-Threading 기술을 활성화 함.

[Disabled] 운영 체제가 HT 기능을 지원하지 않으면 비활성화 함.

▶ **Active Processor Cores Control [All]**

활성 CPU 코어의 수를 선택할 수 있습니다.

▶ **Limit CPUID Maximum [Disabled]**

이 항목을 사용하여 확장 CPUID 값을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] BIOS 는 최대 CPUID 입력 값을 제한하여 확장 CPUID 값으로 프로세서를 지원하지 않는 이전 운영제제의 부팅 문제를 해결할 수 있습니다.

[Disabled] 실제 최대 CPUID 입력 값을 사용합니다.

▶ **Intel Virtualization Tech [Enabled]**

이 항목을 사용하여 Intel Virtualization technology(인텔 가상화 기술)을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

[Enabled] 이 기술을 활성화하면 플랫폼이 독립적인 파티션에서 여러 운영체제를 실행할 수 있고 시스템은 여러 개의 가상화 시스템으로 작동합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel VT-D Tech [Disabled]**

이 항목을 사용하여 Intel VT-D (Intel Virtualization for Directed I/O) 기술을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

▶ **Hardware Prefetcher [Enabled]**

하드웨어 프리페처(MLC Streamer prefetcher) 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 하드웨어 프리페처가 자동으로 데이터와 명령을 메모리에서 L2 캐시에 프리 페치하여 CPU 성능을 조정합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

CPU 하드웨어 프리페처(MLC Spatial prefetcher)를 활성화 또는 비활성화합니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 캐시 지연 시간을 줄이고 특정 응용 프로그램의 성능을 조정할 수 있습니다.

[Disabled] 지정된 캐시 라인만을 활성화합니다.

▶ **CPU AES Instructions [Enabled]**

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

▶ **Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]**

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU의 과열을 방지할 수 있습니다.

[Enabled] CPU의 온도가 적응 온도보다 높을 경우, CPU 코어의 클럭 속도를 낮춰줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Intel C-State [Auto]**

이 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. C-state는 ACPI에 의해 정의된 프로세서 전원 관리 기술입니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enabled] 시스템의 유휴 상태를 감지하고 그에 따라 CPU의 전력 소모를 줄여줍니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **C1E Support [Disabled]**

C1E 기능을 활성화 또는 비활성화하여 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다. 이 항목은 **Intel C-State** 기능이 활성화된 경우 나타납니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 CPU 주파수 및 전압을 줄이고 시스템 유휴 상태에서 전력을 절약할 수 있습니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화합니다.

▶ **Package C State limit [Auto]**

시스템 유휴 상태에서 전력 절약을 위한 CPU C-state 레벨을 선택할 수 있습니다. 이 옵션 C-state 항목은 설치된 CPU에 따라 제공되며 **Intel C-State**기능이 활성화된 경우 나타납니다.

▶ **CFG Lock [Enabled]**

MSR 0xE2[15], CFG 락 비트를 잠금/잠금해제 합니다.

[Enabled] CFG 락 비트를 잠급니다.

[Disabled] CFG 락 비트를 잠금 해제 합니다.

▶ **Long Duration Power Limit (W) [Auto]**

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 장 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▶ **Long Duration Maintained (s) [Auto]**

이 항목은 "장 기간 전원 제한(W)"의 유지 시간을 설정할 수 있습니다.

▶ **Short Duration Power Limit (W) [Auto]**

이 항목은 Turbo Boost 모드에서 CPU의 단 기간 TDP 전원 제한 값을 설정할 수 있습니다.

▶ **CPU Current Limit (A) [Auto]**

터보 부스트 모드에서 CPU 패키지의 최대 전류 제한 값을 설정합니다. 전류가 지정된 제한 값을 초과할 경우, CPU는 자동으로 코어 주파수를 낮춰 전류를 줄여줍니다.

▶ **FCLK Frequency [Auto]**

이 항목을 사용하여 FCLK 주파수를 설정합니다. FCLK 주파수를 감소하면 베이스 클럭 주파스를 증가하는데 도움이 될 수 있습니다.

▶ **DMI Link Speed [Auto]**

이 항목을 사용하여 DMI 속도를 설정합니다.

▶ **SW Guard Extensions (SGX) [Software Control]**

Intel SGX 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

소프트웨어 설명

Windows® 10 운영 체제 설치하기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. Windows® 10 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart(다시 시작)** 버튼을 누릅니다.
4. 컴퓨터가 POST(Power-On Self Test)하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
5. 부팅 메뉴에서 광 드라이브를 선택합니다.
6. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD...**라는 메시지가 나타나면 아무 키나 누릅니다.
7. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows® 10 운영 체제를 설치합니다.

드라이버 설치하기

1. Windows® 10 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다 .
2. MSI® 드라이버 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
3. 설치 화면이 자동으로 나타나고 필요한 모든 드라이버를 찾아서 목록으로 나열합니다.
4. **Install(설치)** 버튼을 클릭합니다.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK(확인)** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
7. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

유틸리티 설치하기

유틸리티를 설치하기 전에 드라이버 설치를 완료해야 합니다.

1. MSI® 드라이버 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
2. 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
3. **Utilities(유틸리티)** 탭을 클릭합니다.
4. 설치하려는 유틸리티를 선택합니다.
5. **Install(설치)** 버튼을 클릭합니다.
6. 유틸리티 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
7. **OK(확인)** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
8. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment.

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.
The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

クラスB情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って
正しい取り扱いをして下さい

VCCI-B

C-Tick Compliance

N1996

Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.
For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH
To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...
Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot

be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH
Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS
En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ
Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....
В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL
MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....
De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI
Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...
Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI
Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE
Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY
Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...
Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR
Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...
Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池**	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 產品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Copyright

MSI Micro-Star Int' l Co.,Ltd.
Copyright © 2018 All rights reserved.

The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int' l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://**www.msi.com**
- Register your product at: http://**register.msi.com**

Trademark Recognition

All product names used in this manual are the properties of their respective owners and are acknowledged.

Revision History

Version 3.0, 2018/04, First release.